



KMT-1171 LED 有机硅灌封胶

特性

- 单组分加成型硅橡胶
- 存储期长无沉淀
- 高触变性不易流淌
- 优异的光、热稳定性
- 良好的粘接性
- 电性能优异
- 杂质离子含量低

产品应用

LED 红外发射管等光电器件的封装

产品性能

固化前

外观	半透明液体
粘度	14000 mPa s
折射率	1.41

建议固化条件: 70°C/1 小时+150°C/2 小时

固化后

硬度	36 Shore A
比重	1.04
抗拉强度	3 MPa
断裂伸长率	220%
透射率[1mm 厚、450nm]	92%
Young's 模量	1.2 MPa
线膨胀系数	$3.0 \times 10^{-4} / \text{k}$
热传导率	0.2 W/m · K
体积电阻率	$3 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
介电强度	23kV/mm
Tg	-125°C
CTE	305 ppm/°C
离子含量 (Na ⁺ ,K ⁺ ,Cl ⁻)	<2,<2,<1 ppm

- 以上数据在 25°C 下测得, 均为非规格值, 使用材料前请进行试验, 确认是否适合使用目的。
- 性能可以根据客户要求进行调整。



KMT-1171 LED 有机硅灌封胶

使用方法

使用前需将包装瓶在室温下放置 2~4 小时, 待其恢复到室温后再开启封口, 以防产品吸潮。并用洁净的搅拌棒将物料搅拌 3~5 分钟, 使胶液均匀后再倒出, 在室温下真空或离心脱气, 以除去扰动时混入的空气。

而后根据工艺条件对光电器件进行封装。

使用注意事项

固化阻碍 (催化剂中毒)

有些材料、化合物、固化剂和增塑剂等, 会阻碍加成型有机硅材料的固化, 主要包括:

- 有机锡和其它有机金属合成物
- 含有机锡催化剂的硅橡胶
- 硫、聚硫化物、聚砜类物或其它含硫物品
- 胺、氨基甲酸乙酯或含胺物品
- 不饱和的碳氢增塑剂
- 某些助焊剂残余物

如果对某物质或材料是否会引起阻碍固化存有疑问, 建议做小型测试试验, 以确定在此应用中的适用性。

清洗

未固化的胶液可使用丙酮或二甲苯清洗, 但水和乙醇达不到清洗效果。

运输及贮存

物料应避免阳光直射, 运输及贮存需在低温下进行, 推荐 $-25 \sim -5^{\circ}\text{C}$ 。并采取预防措施, 保持容器密封, 防止物料接触湿气。

包装瓶开启后应尽快使用完, 在室温下存放时间不得超过 12 小时, 超过 12 小时后应再次密封并在 $-25 \sim -5^{\circ}\text{C}$ 下贮存。

保质期: 6 个月

包装

500g/瓶; 6Kg/箱